

2024中国（上海）国际半导体展览会

产品名称	2024中国（上海）国际半导体展览会
公司名称	上海瑞秀会展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:瑞秀会展 经验:10年以上 发货地:上海
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢1928室
联系电话	18717735710 18717735710

产品详情

展会时间：2024年11月18-20日

论坛时间：2024年11月18-19日

展会地点：上海新国际博览中心

展会规模：50,000平方米、800家展商、90,000名专业观众

展会介绍：

中国市场的半导体销售占了全球的1/3，是份额最大的，相当于美国、欧盟及日本的总和，不过这主要是因为中国是全球制造的中心，

尤其是电脑、手机产量第一，消耗了最多的芯片。随着人工智能的快速发展，以及5G、物联网、节能环保、新能源汽车等战略性新兴产业的推动下，

半导体的需求持续增加。预计2024年中国半导体市场需求规模将进一步扩大，市场需求规模有望达到19850亿元。

为更好的推动半导体业界交流互动，提升半导体行业国际化水平，“2024中国（上海）国际半导体展览会（CDISEE-2024）”

将于2024年11月18-20日在上海新国际博览中心隆重召开。CDISEE-2024分为展览会、高峰论坛和学术会议三大板块，是半导体行业的年度盛会，

也是半导体行业和相关产业交流合作的综合性专业展示平台。

同期活动：

展会期间还将举办中国半导体发展高峰论坛、中国电子电路应用发展论坛、新产品与新技术发布会、买家见面会等多场论坛与活动，

通过活动的举办聚焦行业前沿的高端研讨会、现场互动多样的活动及务实高效的专业买家对接会等，丰富的展会内容向业内人士以及各界传递最新、最全的行业资讯。

展示内容：

半导体设计（设计软件、硬件设计）展区：集成电路设计及芯片、晶圆制造、IC设计与产品、IC设计工具及服务、电子设计自动化；

半导体制造展区：晶圆制造、制造技术、晶圆制造工艺、光刻工艺、蚀刻工艺、掩膜、洗技术；

半导体封装检测展区：封装/组工艺、先进封测工艺、IC测试方法与测试仪器、封装测试服务、封装设备、测试设备、半导体扩散设备、焊接设备、清洗设备、制冷设备、氧化设备、激光设备；

半导体材料和设备展区：硅片及硅基材料、光掩模板、电子气体、光刻胶及其配套试剂、CMP抛光材料、靶材、引线框架、键合丝、陶瓷基板、芯片粘合材料等，减薄机、单品炉、研磨机、热处理设备、光刻机、刻蚀机、离子注入设备、CVD/PVD设备、清洗设备切割机、装片机、键合机、测试机、分选机、探台及零部件等；

第三代半导体及终端应用展区：氮化(GaN)和碳化硅(SiC)、氧化锌(ZnO)、金刚石、晶圆、衬底与外延、功率器件、IGBT封装材料、射频器件及加工设备等。